

積層チップバリスタ

コンパクトな形状で大きなサージ電流耐量を実現

- 8/20 μ s サージ電流耐量 5,000 A のきわめて高い耐サージ電流特性
- EIA1210～2220 のコンパクトな形状
- 使用温度範囲+125 $^{\circ}$ C (ディレーティングなし)

2015年6月30日

TDK株式会社(社長:上釜 健宏)は、EPCOSブランド積層チップバリスタ MLV シリーズを発表します。本シリーズは、最大許容回路電圧 65 V DC、8/20 μ s サージ電流 1 回印加時で電流耐量が 5,000 A max.、10 回印加時で 3,500 A max.と、きわめて大きなサージ電流耐量を特長とします。また、面実装 (SMD) タイプで、ケースサイズ EIA1210～2220 (3.2mm \times 2.5mm～5.7mm \times 5.0mm) のきわめてコンパクトな設計です。リード線付ディスクバリスタやツェナーダイオードなどの半導体系サージ吸収素子と同等の性能や信頼性を備えながら、大幅な省スペース化を実現しています。

本シリーズは、新組成高性能セラミック材料の採用と素子設計の改良により、従来製品比約 3 倍の電流密度を得ることに成功しました。これにより、面積比で約 3 分の 1 の EIA1210 まで小型化することが可能となりました。EIA1210 のコンパクトな形状でありながら、最大エネルギー耐量は 2ms パルス印加時で約 15J と、従来シリーズの EIA2220 と同じ特性を実現しています。

さらに、本シリーズは機械的強度にも優れ、熱機械特性が高いのも特長です。

他にも、125 $^{\circ}$ C の高温下でもディレーティングがないため、高温領域でもきわめて高いサージ吸収性能を発揮します。また、鉛フリーのリフローはんだ付けプロセスに対応し、実装信頼性も万全です。

本シリーズは、通信システムや PoE (Power-over-Ethernet) システムの電源の過電圧保護に好適です。

主な用途

- 通信システム電源の過電圧保護対策
- PoE システム電源の過電圧保護対策

主な特長と利点

- 8/20 μ s サージ電流耐量 5,000 A のきわめて高い耐サージ電流特性
- EIA 1210～2220 のコンパクトな形状
- 使用温度範囲+125 $^{\circ}$ C (ディレーティングなし)
- 鉛フリー

TDK 株式会社について

TDK 株式会社（本社：東京）は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。

主な製品としては、各種受動部品*（製品ブランドとしては TDK、EPCOS）をはじめ、電源、HDD ヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。

2015 年 3 月期の売上は約 1 兆 800 億円で、従業員総数は全世界で約 88,000 人です。

*主な製品は、コンデンサ（積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ）、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

本文および関連する画像は www.epcos.co.jp/pressreleases からダウンロードできます。

製品の詳細情報は www.epcos.co.jp/inquiry で参照できます。

お問合せは marketing.communications@epcos.com までお送りください。

報道関係者の問い合わせ先

担当者	所属	電話番号	Email Address
手島	TDK 株式会社 広報グループ	+81 3 6852-7102	pr@jp.tdk.com